

Investor Relations 2021



Disclaimer

본 자료는 제안된 IPO공모와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사아스플로(이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.



AEROSPACE & SEMICONDUCTOR FLOW

품질 최우선 경영, 반도체 부품 소재 산업의 선두주자 ASFLOW

TABLE OF CONTENTS

Prologue

CHAPTER 1. 회사 소개

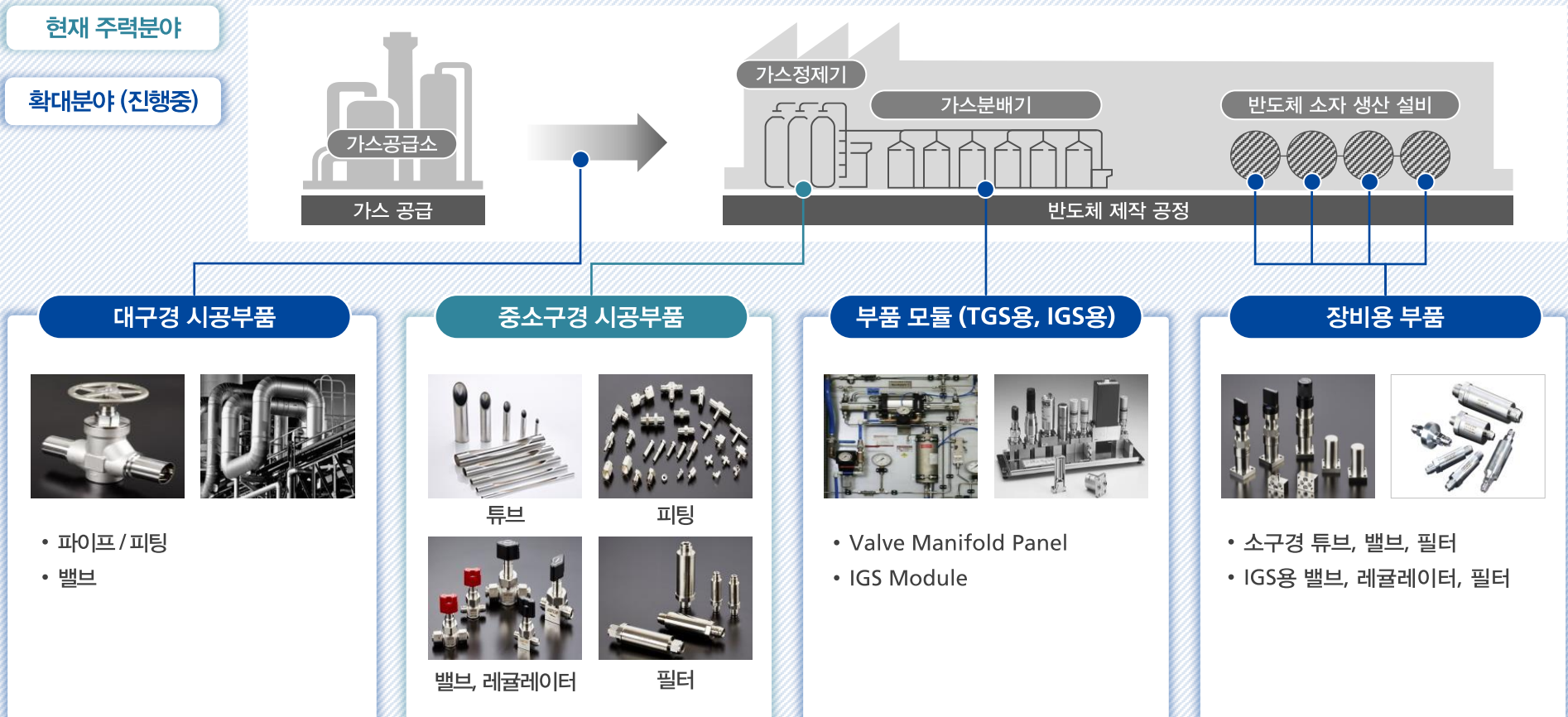
CHAPTER 2. 핵심 경쟁력

CHAPTER 3. 투자 포인트

Appendix



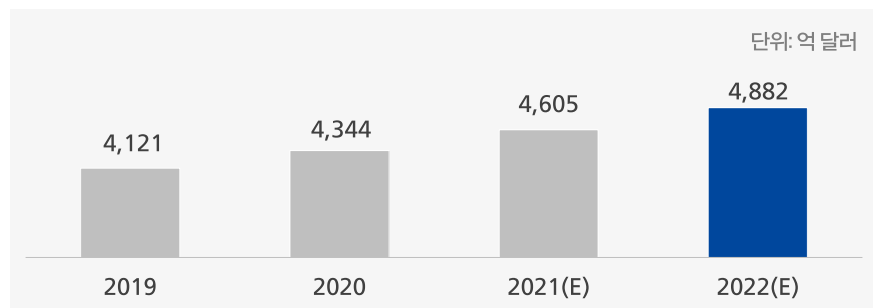
반도체 공정 가스공급 및 제어공정 부품 일괄 개발/생산 능력 보유



반도체 산업과 동반 성장

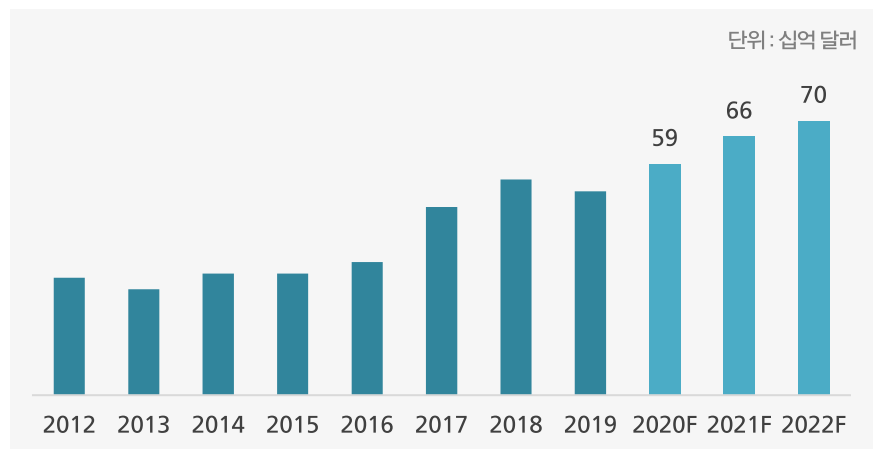
반도체 산업 성장과 일본 수출규제 강화로 전망되는 ‘부품 국산화 선도기업’ 아스플로의 도약

반도체 산업 성장



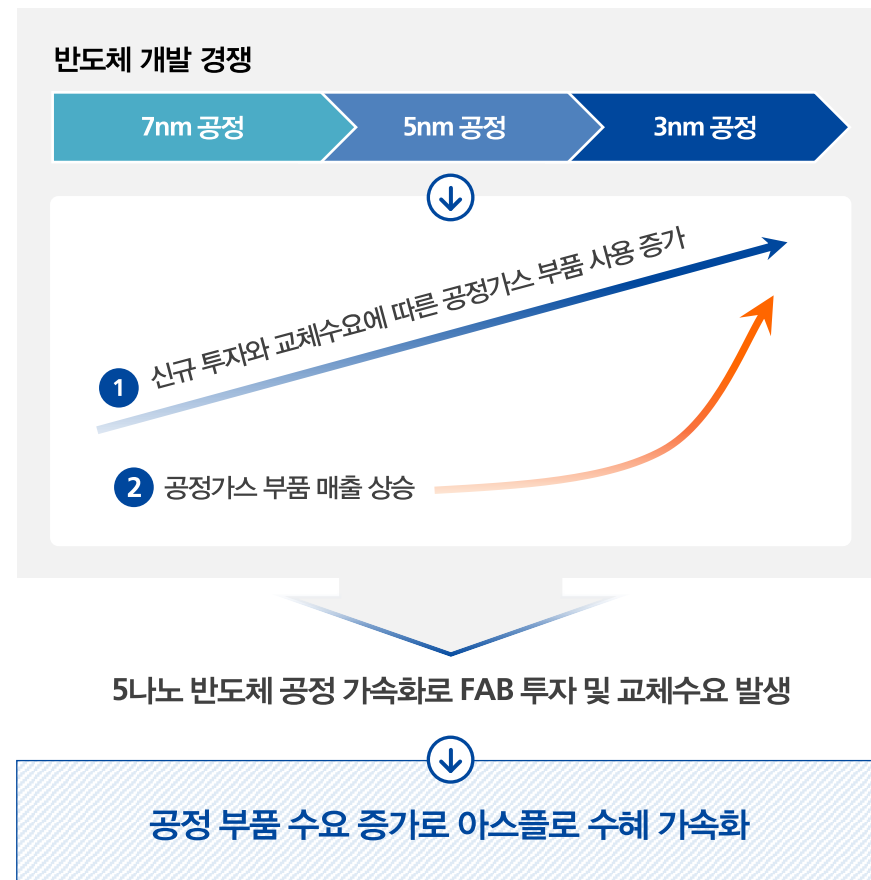
출처: SWTW(Semiconductor Wafer Test Workshop) 2019, 반도체협회 2019 통계

글로벌 FAB 설비투자 계획



출처: Semiconductors, Equipment and Materials Market Outlook, (2020, SEMI)

나노소재 개발 가속화에 따른 FAB 투자 수혜 전망



소재 부품 국산화 선도기업 (으뜸 기업 선정)

일본 수입 부품의 국산화를 선도하고 있는 22개 기업에 선정되어 120억 원 정부지원 수혜

으뜸기업 선정 기준과 혜택

"2021년 부터 4년 총 120억 원 지원금 수혜"

아스플로의 으뜸기업 선정 기준

- 2020년 산업통상자원부의 100대 핵심전략품목으로 선정
- 100대 핵심전략품목 중 기계금속 분야, 최고 기술 보유 기업
- 반도체용 고순도 공정가스 공급을 위한 극청정 강판 제조기술 개발



으뜸기업 선정되기 위한 주요 조건

- **소재 부품 국산화 전문 기업**
- 소부장 핵심전략기술 분야 국내 최고 기업
- 에코프로비엠, 주성엔지니어링, 동진세미켐 등 22개 기업 최종 선정

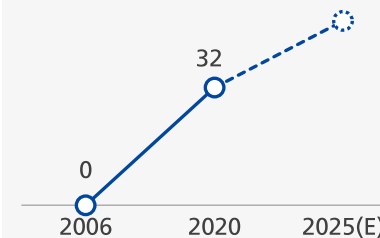


반도체 공정가스 주요부품 국산화 현황

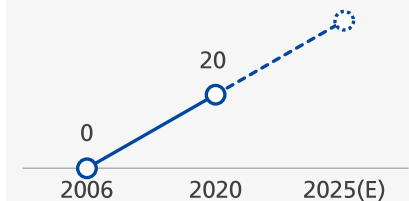
○ 아스플로의 국산화를 통한 시장점유율

단위: %

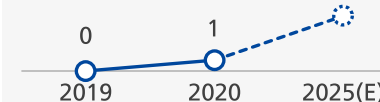
튜브, 파이프



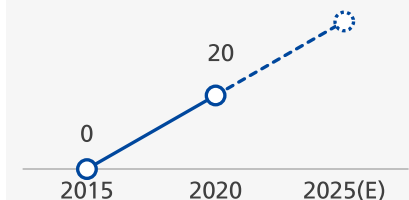
피팅



필터, 디퓨저



밸브, 레귤레이터



주1: 아스플로 자체 추정

주2: 튜브, 파이프, 피팅, 밸브는 삼성전자&SK하이닉스 공급기준 / 필터는 장비사 공급기준

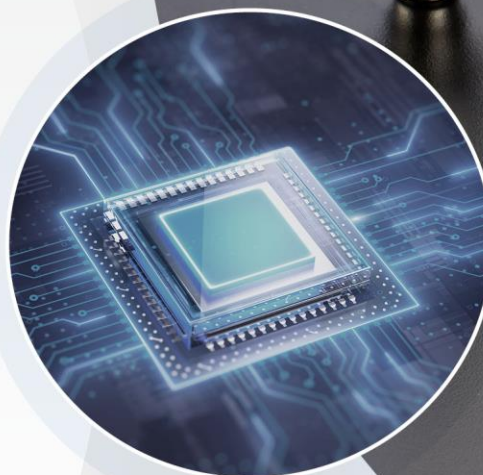


A Leader In Semiconductor
Components and Materials Industry

CHAPTER 1

회사소개

- 01. Corporate Identity
- 02. 회사 개요
- 03. 성장 스토리
- 04. 주요 제품 소개
- 05. 경영성과



반도체 공정가스 공급 및 제어용 부품소재 글로벌 전문기업

**독보적인 부품 일괄
Line-up**

**가스공급과 관련된
반도체 부품 일괄 생산**

세계 유일
반도체 공정 가스공급 관련
전 부품 생산 경쟁력 보유

원천 경쟁력

**반도체 공정가스부문
부품소재 국산화**

반도체 공정가스 부품
최초 국산화로 기술력 인정

사업영역 다각화

**시공부품 영역 확대와 함께
장비 & 부품 모듈 시장 진입**

대구경 시공부품 확대
반도체 공정가스 부품사업 확장
반도체 부품 모듈사업 진출

품질 최우선 경영, 반도체 부품 소재 산업 선두주자 ASFLOW

회사 현황

회사명	주식회사 아스플로
대표이사	강 두 홍
설립일	2001년 11월 28일
자본금	19억 원
임직원수	130명
업종	반도체 공정용 가스 부품(강관, 피팅, 밸브류 등) 제조
주소	경기도 화성시 정남면 정남산단로 38

주: 2021년 8월 말 기준

CEO

강 두 홍 대표이사

주요 이력

- 現) 아스플로 대표이사
- 진일특수 개발팀
- EP연구소 연구소장

주요 수상

- 산업포장상(중소벤처기업부)
- 디지털이노베이션 대상(한국일보)



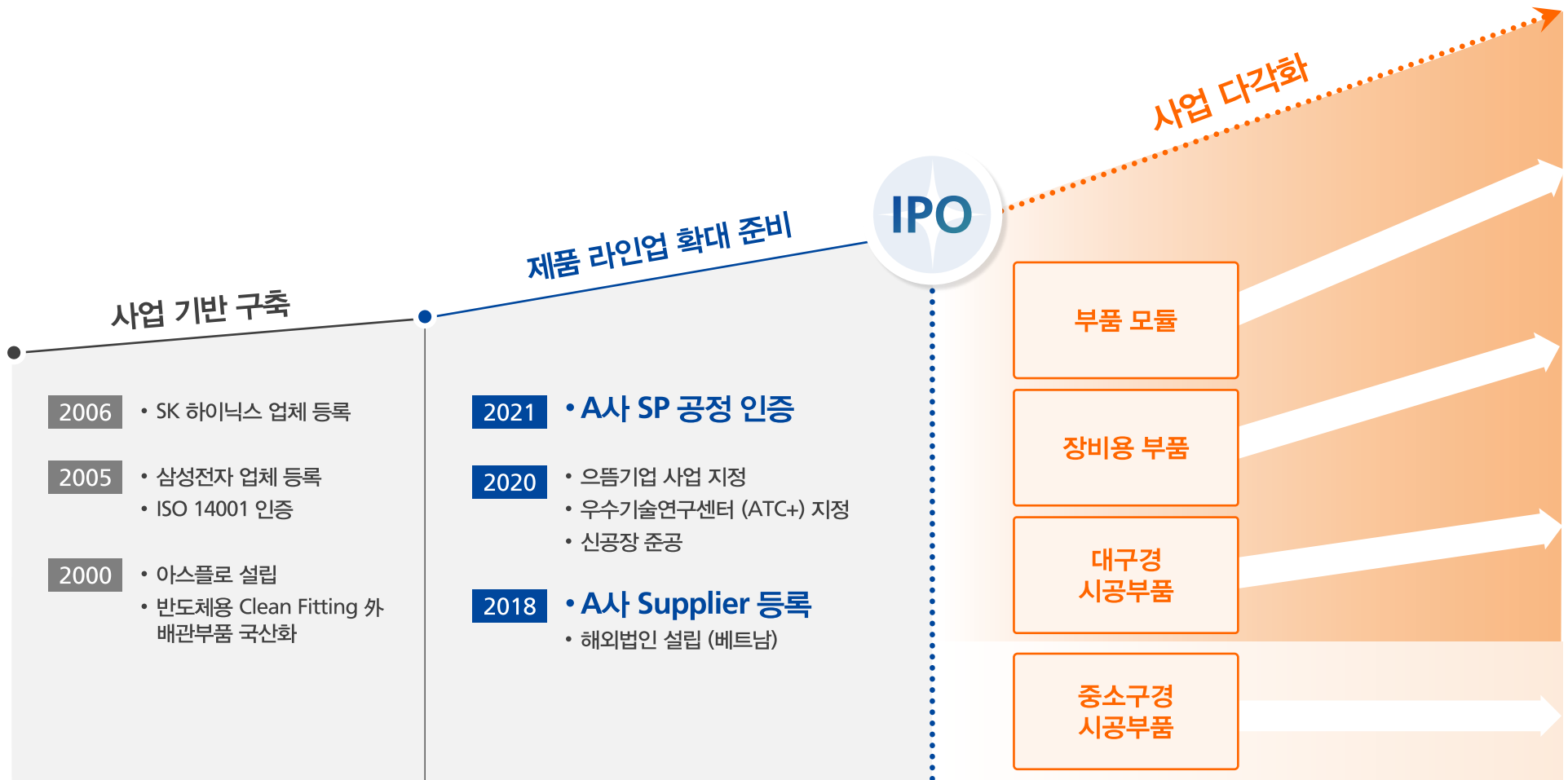
경영 철학

성장엔진
확보를 우선하는
기술혁신 회사

핵심역량
증대를 위한
수익기반 강화

핵심역량
능력 증대를
위한 기업문화를
혁신하는 회사

반도체 공정가스부문의 글로벌 부품소재 전문기업으로 도약



반도체 공정상 가스를 공급원에서 공정장비로 이송하는 고정밀, 고청정 공정부품

튜브, 파이프

- 반도체 공정가스 이송 부품
- 거울 같은 표면의 극청정 부품



피팅

- 튜브 및 파이프 연결, 각도 조정, 이송량을 감소시킬 때 사용
- 거울 같은 표면, 극청정성, 우수한 직진도 및 직각도 형태의 고정밀 부품



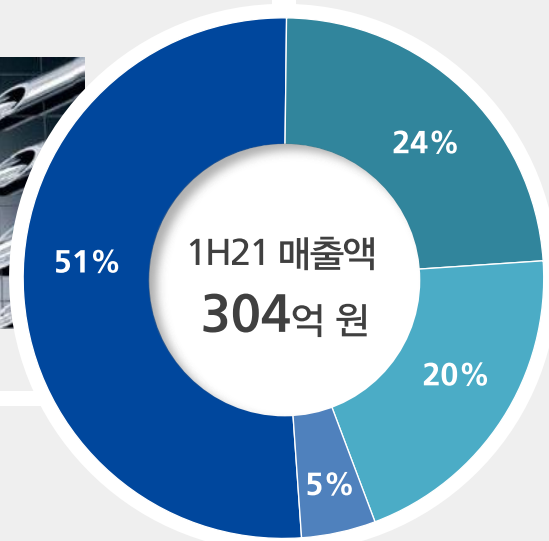
필터, 디퓨저

- 가스 이송 공정상 이물질을 거르는 부품과 진공 해제 시 웨이퍼 파손 방지 부품
- 10 μ m 이하(머리카락 굵기의 1/5 이하 수준) 금속 분말로 만든 기공을 30% 수준의 다공성 금속 소재



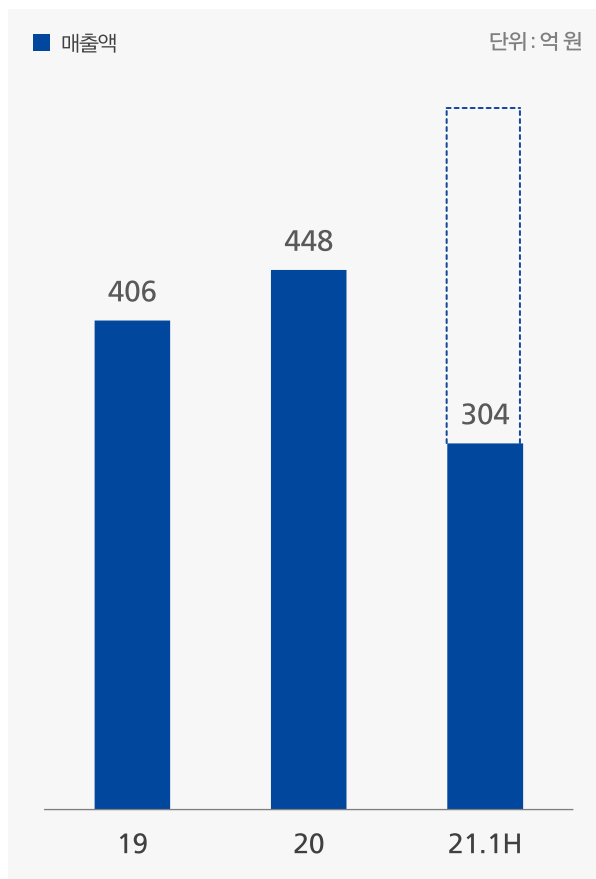
밸브, 레귤레이터

- 공정가스의 흐름 조정 및 압력 유지 부품
- 고기능성 소재 원천 기술을 통해 고객 니즈에 대응

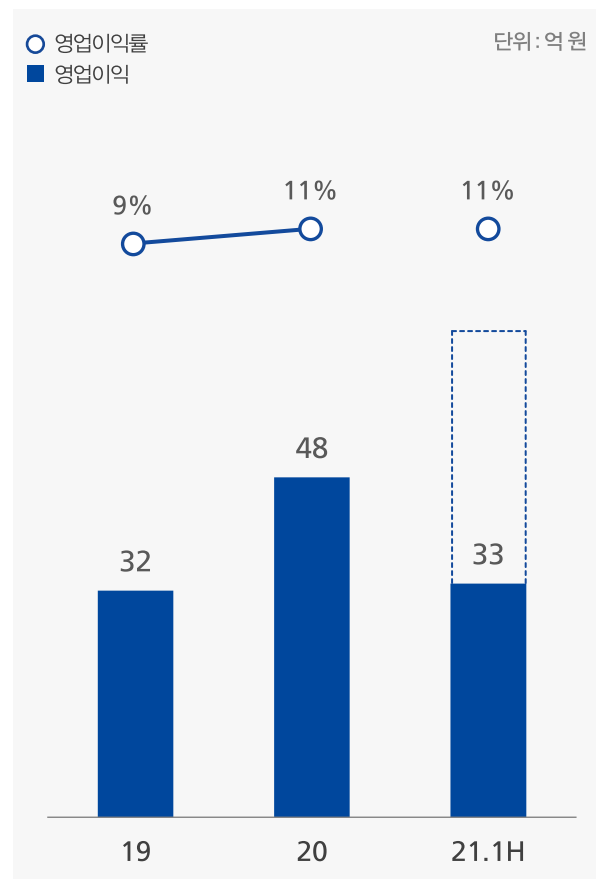


핵심 부품 기반의 지속적인 매출 성장 및 고부가 가치 부품의 매출 증가로 이어지는 꾸준한 성장

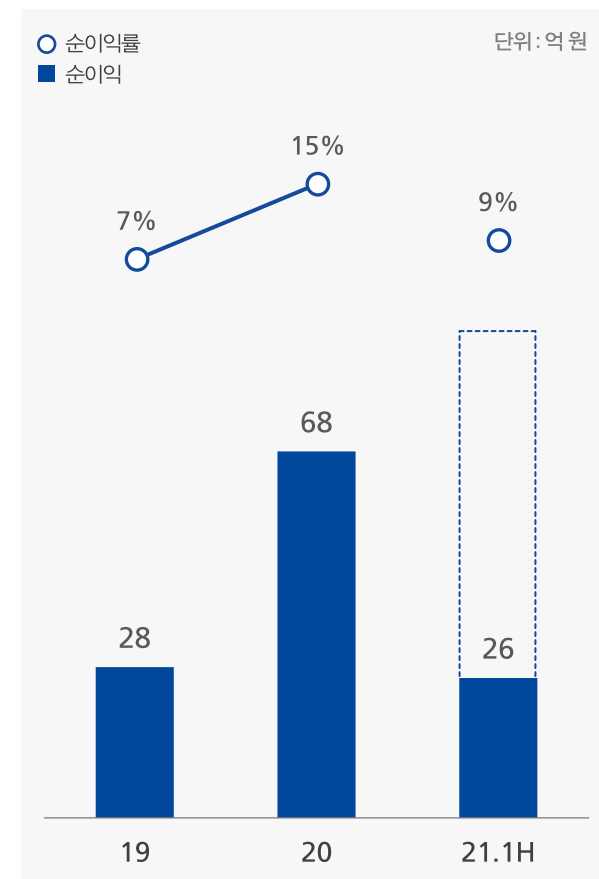
매출액



영업이익(률)



순이익(률)





A Leader In Semiconductor
Components and Materials Industry

CHAPTER 2

핵심 경쟁력

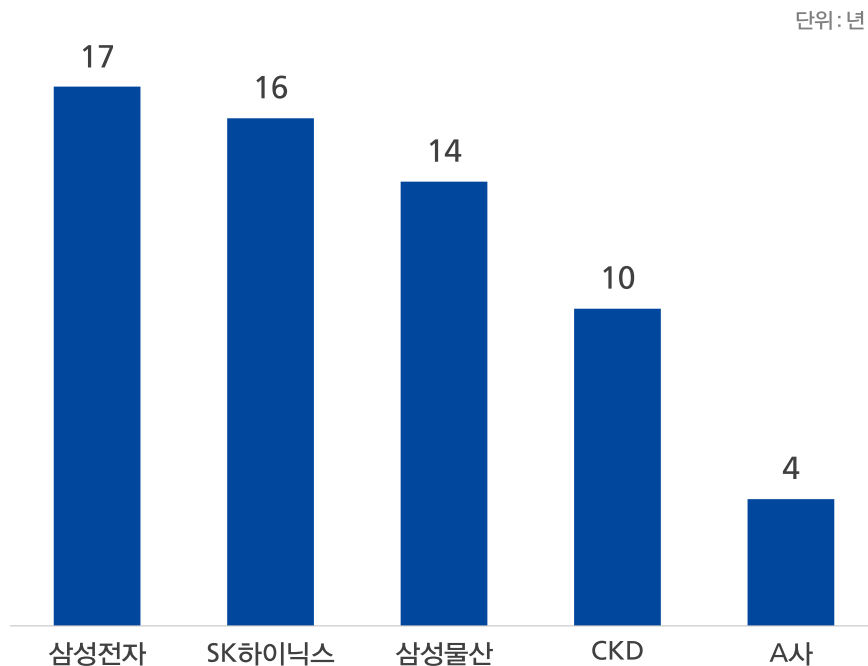
- 01. 글로벌 고객사와의 장기 파트너십
- 02. R&D 경쟁력
- 03. 주요 기술 소개
- 04. Total solution provider
- 05. 산업의 확장성



삼성전자, SK하이닉스의 1차 벤더로 15년 이상 동반 성장 파트너십 유지

주요 고객 거래

- 반도체 공정가스 부품기업 중 삼성전자, SK하이닉스와 15년 이상 거래중 (국내 유일)
- 신규 고객사 글로벌 장비 1위 기업 A사 확보

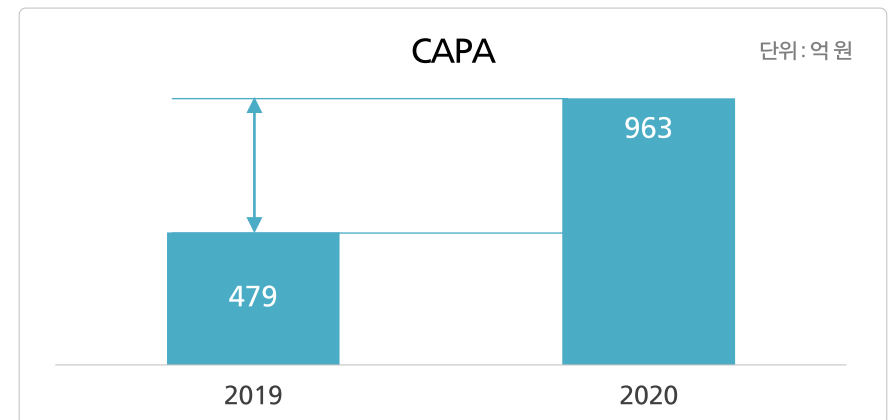


대규모 설비 구축

올해 대규모 설비 구축으로 규모의 경제를 통한 원가 절감 체제 구축

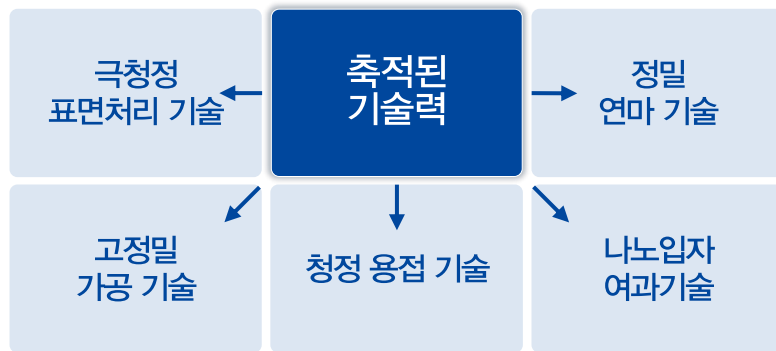


CAPA 확대로 신규 고객 대응능력 확보



폭넓은 연구개발 이력 및 우수한 R&D 인프라 형성

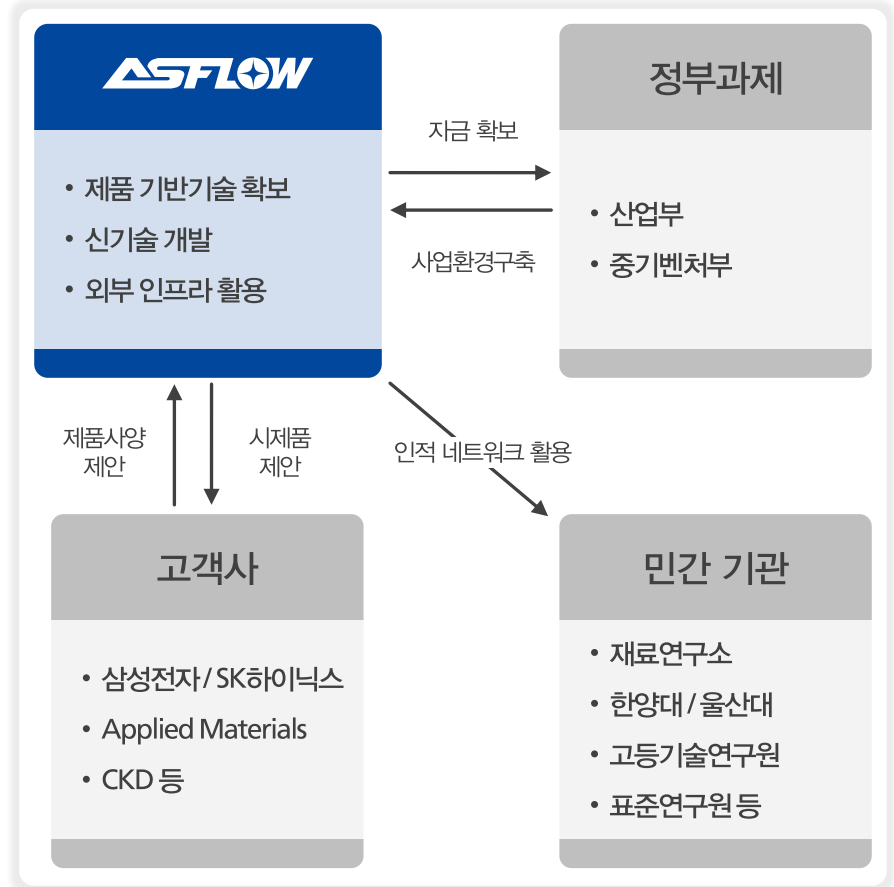
주요 R&D 경쟁력



핵심 기술을 응용하여 다양한 개발 계획 진행 중

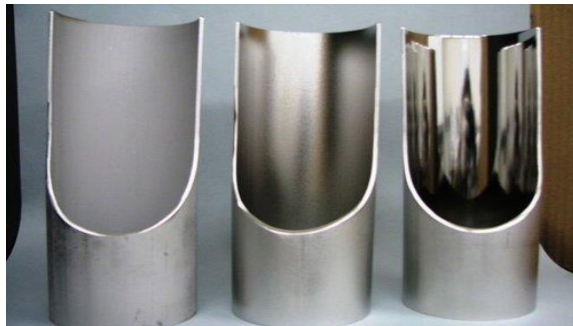
기술과제명	연구기간	과제 설명	관련제품
전략핵심소재 자립기술개발	'20.04~'24.12	반도체 공정가스용 부품소재 국산화 실증 개발	극청정 튜브, 밸브, 레귤레이터 등
우수기술연구 센터지원사업	'20.06~'23.12	3D 프린팅 필터 개발	극청정 나노 입자 여과 필터
지역소부장 상용기술지원 사업	'20.06~'21.12	가스켓 필터 상용화 개발	가스켓 필터
나노산단 구축사업	'18.10~'21.08	나노패턴 소재를 활용한 입자 및 유해가스 동시제거 필터개발	IGS형 부품

R&D 인프라



최고의 반도체 공정가스 부품 제조기술로 트렌드 세터 입지 구축

극청정 표면처리 기술



소재 내벽에 잔존하는 오염물질/결함/흡집 등을 완벽히 제거하여 거울처럼 깨끗하게 만드는 기술

직경 1/4" ~ 600A 의 다양한 제품

SEMI 기준에 부합하는
UHP (Ultra High Purity)급 극청정도

고정밀 가공 기술



고순도 가스가 일정한 양과 압력으로 공급되도록 설계하는 기술

다이하프램 밸브, 벨로우즈 밸브
ALD 밸브 등 모든 종류의 밸브기술 보유

Cv 0.2 ~ 5의 다양한 유량
직경 1/8" ~ 200A의 다양한 제품

나노입자 여과 기술



초미세 스테인리스 스틸 금속분말로 수 nm 급 입자를 제거하는 여과체 설계기술

2.5nm 입자 99.999999% 제거 가능

30LPM ~ 300LPM의 다양한 유량
(LPM : Liter Per Minute)

고객사 변화에 실시간 대응 가능한 강력한 공정가스 부품 Total solution provider 역량

공정가스 부품 일괄생산 시스템 구축



제품별 경쟁력 보유

- 반도체 시공 부품 및 장비용 부품 Total solution provider
- 튜브, 파이프, 피팅, 밸브, 레귤레이터, 필터, 디퓨저 등 공정 및 장비에 사용되는 모든 종류의 부품을 생산 및 공급 할 수 있는 전세계 유일한 경쟁력 확보

- 장비, 시공 제품 보유
- 장비, 시공 일부 보유
- 불가능

	ASFLOW	T사	V사	S사
튜브/파이프	●	○	●	○
피팅	●	●	○	●
밸브/레귤레이터	○	●	○	●
필터/디퓨저	○	○	○	○
모듈	●	●	○	○

반도체 산업 외 다양한 산업으로 확장성이 높은 공정가스 제어 비즈니스





A Leader In Semiconductor
Components and Materials Industry

CHAPTER 3

투자 포인트

- 01. 비전 및 비즈니스 확대 전략
- 02. 시공 부품 Line up 확대
- 03. 장비용 부품 영역 확장
- 04. 부품 모듈사업 확대
- 05. 추진 사업별 매출 추정
- 06. 세계 선도기업 공략으로 글로벌 기업으로 도약



체계적인 기술 개발과 비즈니스 성장전략 수립으로 실행가능한 미래 비전 제시



02 Investor Relations 2021

시공 부품 Line up 확대



글로벌 고객사들의 중소구경/대구경 일괄공급 니즈로 대구경 제품 공급 확대



가스 플랜트에서 반도체 소자 제조 장비까지 가스를 공급하는 대구경 소재

- FAB 고객들의 대구경 파이프 & 중소구경 Line 일괄 공급 니즈 발생
- 대구경 제품: 기존 중소구경 제품 기술 활용으로 원활한 생산 가능
- 대,중,소구경 제품 Turn-key 공급 능력구축 → Supply Chain 단순화로 시장 확대
- 글로벌 반도체 장비사 공급 실적 기반으로 국내 반도체 장비사로 시장 확대



50A 이하 제품



중소구경 제품

65A~600A 까지 제품 확대



대구경 제품

중소구경



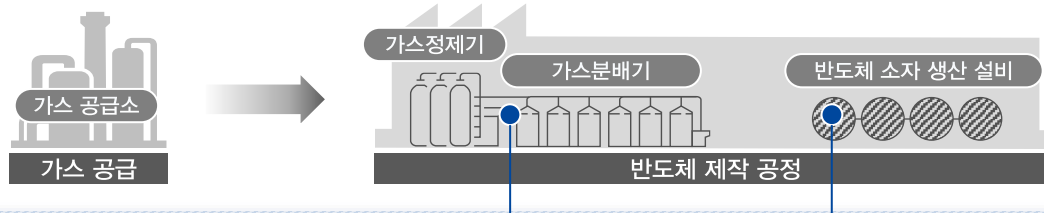
대구경



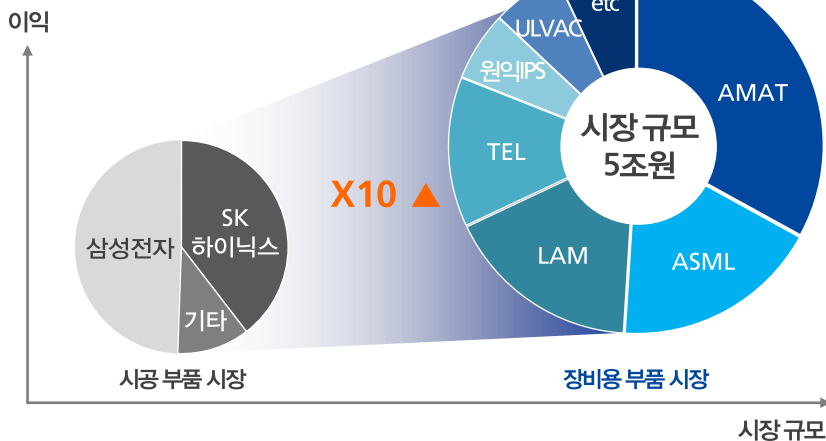
X 3~4 ▲

중소구경 대비 높은 단가로 매출액 상승

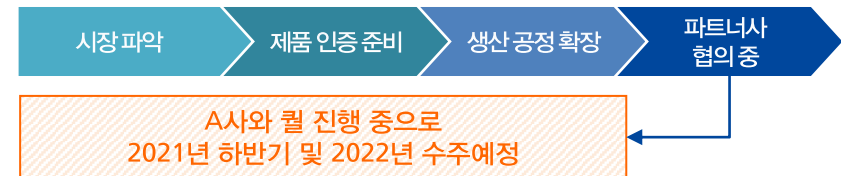
시공 부품 대비 수익성과 시장이 큰 장비용 부품 시장 진출 확대



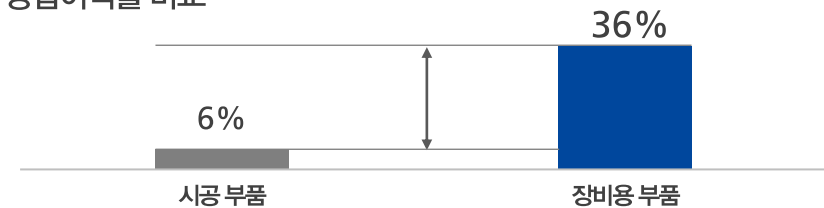
반도체소자 생산설비용 부품에서 장비용 부품으로 시장 확대



A사와 단계별 프로세스 진행



영업이익률 비교



기준 : 2021년 상반기

글로벌 고객사들의 부품공급 통합 관리 니즈 및 요청으로 부품 모듈산업 진출



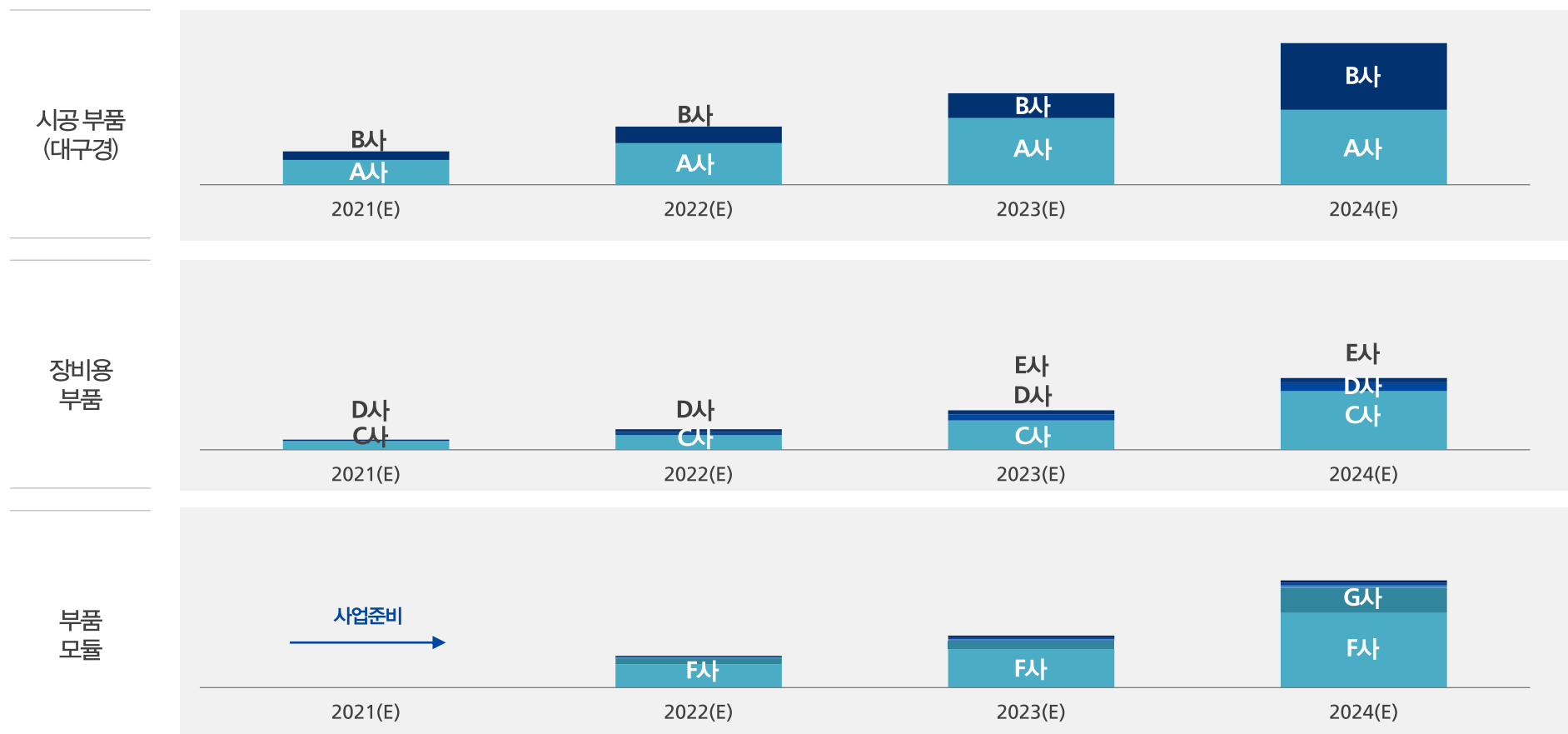
튜브 / 피팅 / 밸브 / 레귤레이터 / 필터 등을 연결한 Panel Module / IGS Module 사업

원가 절감

신속한 납기 가능

사업 확장 가능

글로벌 고객 창출에 의한 매출, 이익 증가로 기업가치 향상 전망



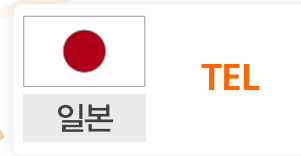
06 세계 선도기업 공약으로 글로벌 기업으로 도약

Investor Relations 2021



글로벌 기업으로 도약한 아스플로는 세계 선도기업들의 성장 기회 확대

■ 시공 부품 고객사
■ 장비용 부품 고객사



K반도체 중장기 투자 전략

SAMSUNG

중국, 미국 반도체 강화에 대응

- 2022년 평택P3 라인가동 준비완료
- 2030년 시스템반도체 38조원 증액
- 매년 메모리 설비 투자 연평균 20조원



글로벌 지위 수성을 위한 투자 확대

- 2025년 용인 반도체 클러스터: 10년간 120조 원 투자
- 이천, 청주공장에 110조 원 설비투자

글로벌 반도체 공략

시공 부품/장비용 부품 공급 확대

- 미국, 일본, 대만 등에 시공/장비용 부품 공급 확대
- Intel, UMC, TSMC, TI 등에 시공 부품 공급 확대
- AMAT, TEL, LAM, ASM 등에 장비용 부품 공급 확대



A Leader In Semiconductor
Components and Materials Industry

Appendix

- 01. IPO PLAN
- 02. 요약재무제표



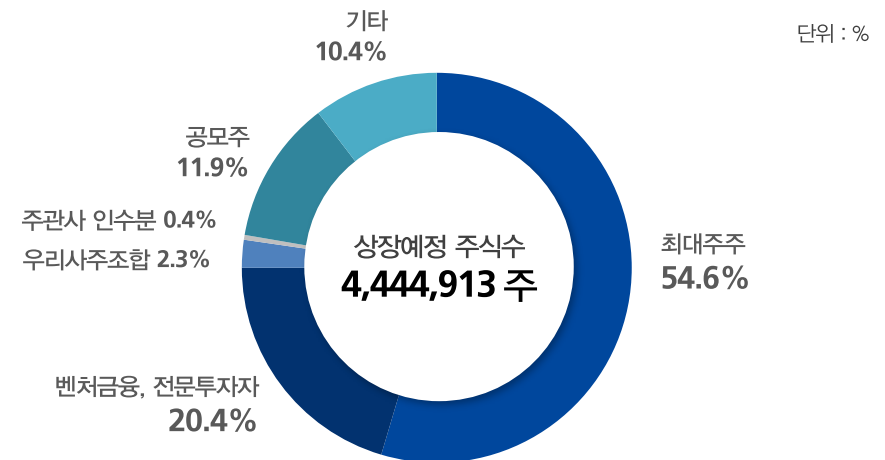
공모개요

공모주식수	630,000 주
공모예정가	19,000 원 ~ 22,000 원
액면가	500 원
총 공모예정금액	120 억 원 ~ 139 억 원
예상 시가총액	845 억 원 ~ 978 억 원
상장예정주식수	4,444,913 주

공모일정

증권신고서 제출	2021년 8월 25일
수요 예측일	2021년 9월 16일 ~ 17일
청약 예정일	2021년 9월 27일 ~ 28일
상장 예정일	2021년 10월 7일 (예정)

공모 후 주주구성



주: 공모주식은 우리사주조합분 제외

· 보호예수사항

주주명	주식수(주)	비중(%)	기간
최대주주 (강두홍)	1,212,220	27.3%	상장일로부터 12개월
우리사주조합	102,000	2.3%	상장일로부터 1년
미래에셋증권(주)	18,900	0.4%	상장일로부터 3개월
합계	2,545,340	57.3%	-